

<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

图书基本信息

书名：<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

13位ISBN编号：9787560322476

10位ISBN编号：7560322476

出版时间：2006-6

出版时间：哈尔滨工业大学出版社发行部

作者：马鑫

页数：334

字数：482000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

内容概要

无铅软钎焊技术作为电子组装行业的新兴技术及未来的发展方向，拥有极大的应用价值和空间。本书从无铅化的根本，即无铅焊料的定义出发，描述无铅焊料的各种基本性能，重点论述无铅软钎焊的物理化学过程，并对电子组装技术的无铅化所面对的技术问题进行分析，最后论述无铅化焊接所带来的电子组装产品可靠性的新问题。

同时，本书结合市场的实际情况，对无铅焊料成分的专利问题也进行详细阐述。

本书可作为高等学校材料加工工程学科的硕士研究生专业课教材，还可以作为焊接技术与工程专业本科生的教学参考书，也可供电子加工企业的从业人员，特别是工程部与品管部的技术人员参考。

。

<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

书籍目录

第一章 时代背景 1.1 欧盟指令 1.2 环保时代与铅的毒性 1.3 铅在电子产品中应用与废弃的污染问题 1.4 无铅化电子组装的国际研发动态 1.5 无铅化电子组装产业实用化的先锋--日本的发展现状 1.6 应对无铅化--中国信息产业部的管理办法 参考文献第二章 无铅化电子组装的基本概念 2.1 无铅化电子组装的含义 2.2 无铅钎料的定义第三章 无铅软钎焊的物理化学过程的基本理论 3.1 钎焊的基本原理及特点 3.2 钎料的润湿与铺展过程 3.3 钎料的毛细填缝过程 3.4 影响钎料润湿性的因素 3.5 表面张力的理论推算第四章 无铅钎料及钎剂的选择 4.1 Sn-Pb钎料的特点 4.2 可能的备选无铅钎料及相关金属分析 4.3 具备产业实用化特征的无铅钎料的性能分析 4.4 典型无铅钎料的应用示例 4.5 无铅钎料的专利问题 4.6 评估无铅钎料供应商需要注意的问题 4.7 无铅钎焊钎剂的选择 参考文献第五章 无铅化焊接技术 5.1 无铅化焊接技术的基本特点 5.2 推荐使用的无铅钎料 5.3 无铅化手工烙铁焊 5.4 无铅化浸焊 5.5 无铅化波峰焊 5.6 无铅回流焊 参考文献第六章 无铅化电子组装带来的新问题 6.1 印刷电路板表面的无铅防护层 6.2 电子元器件的无铅化表面镀层 6.3 无铅化的兼容性问题 6.4 电子元器件的耐热性问题 参考文献第七章 无铅化电子组装焊点可靠性的特殊问题. 7.1 晶须问题 7.2 焊点剥离缺陷 7.3 “曼哈顿”现象 7.4 掉件、焊球和锡珠缺陷 7.5 桥连缺陷 7.6 界面金属间化合物 参考文献第八章 如何顺利导入无铅制程 参考文献附录一附录二 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>